

# 平成20年3月期(第6期)決算説明会

平成20年5月16日  
株式会社ジーダット



**1.平成20年3月期 業績**

**2.平成21年3月期 業績予想**

# 平成20年3月期のポイント

**売上高、経常利益、当期利益共に増収増益**

**半導体市場向けの売上が増大  
FPD市場向けの売上が減少**

**事業の拡大に向けて、業務提携および新規  
事業への投資を実施**

# 平成20年3月期業績概要（連結）

（単位：百万円）

	平成17年3月期 業績		平成18年3月期 業績		平成19年3月期 業績		平成20年3月期業績		
	実績	売上高比	実績	売上高比	実績	売上高比	実績	売上高比	対前年 同期比
売上高	2,171	100.0%	1,835	100.0%	2,095	100.0%	2,136	100.0%	+2.0%
売上総利益	1,537	70.8%	1,284	70.0%	1,473	70.3%	1,478	69.2%	+0.3%
販売費及び 一般管理費	1,114	51.3%	1,141	62.2%	1,266	60.4%	1,256	58.8%	-0.8%
営業利益	423	19.5%	142	7.8%	207	9.9%	221	10.4%	+7.1%
経常利益	468	21.6%	185	10.1%	290	13.9%	294	13.8%	+1.3%
当期純利益	332	15.3%	124	6.8%	189	9.0%	197	9.2%	+4.5%

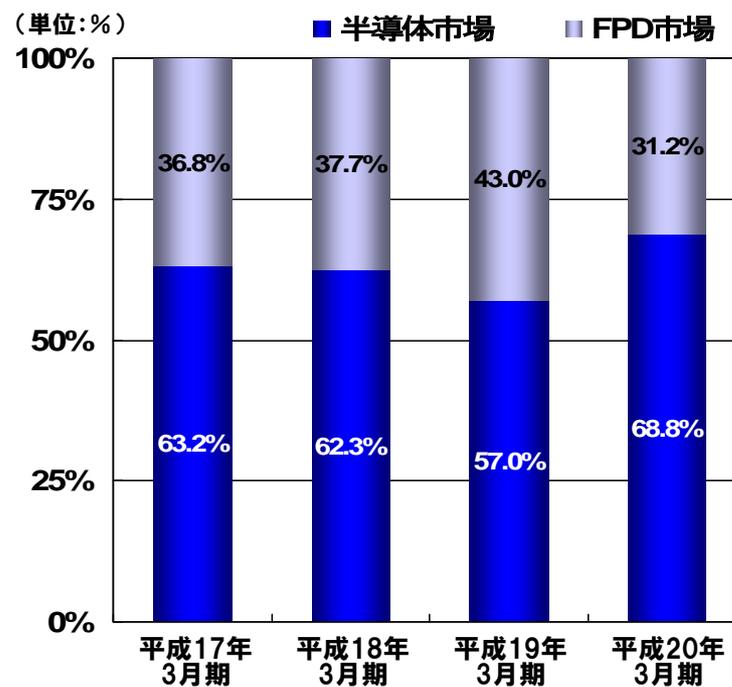
# 事業別売上高の推移(連結)

## 【半導体市場/FPD市場別】

(単位:百万円)



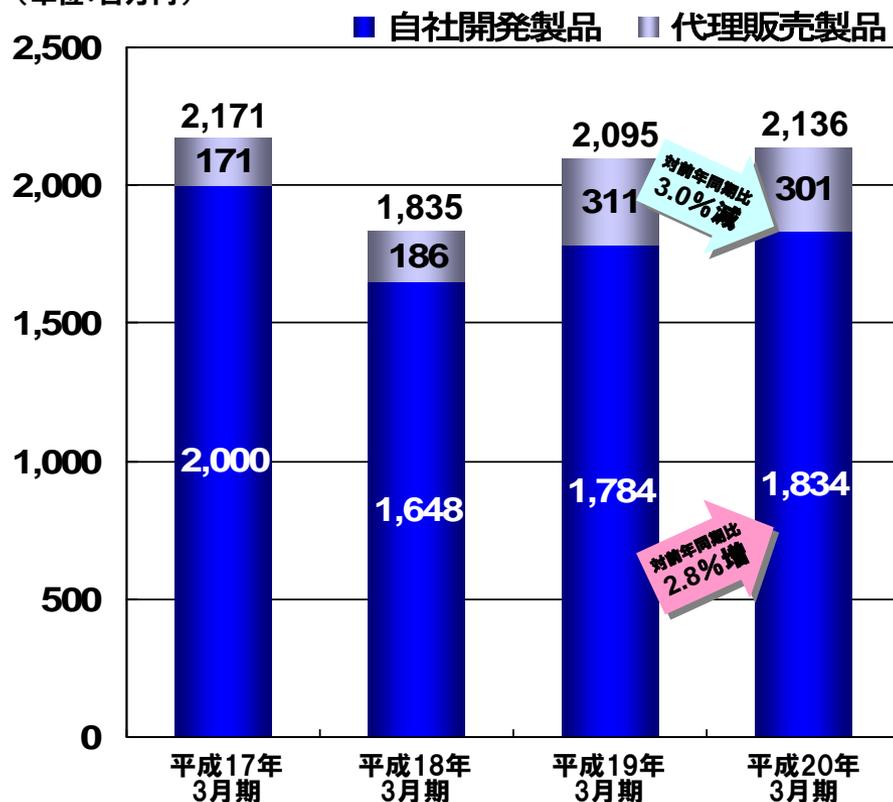
(単位:%)



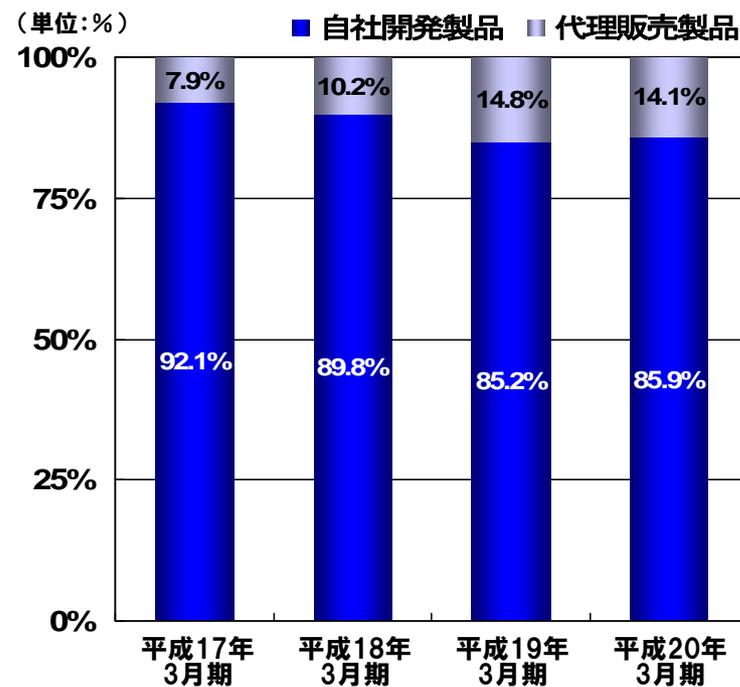
# 事業別売上高の推移(連結)

## 【自社開発製品/代理販売製品別】

(単位:百万円)



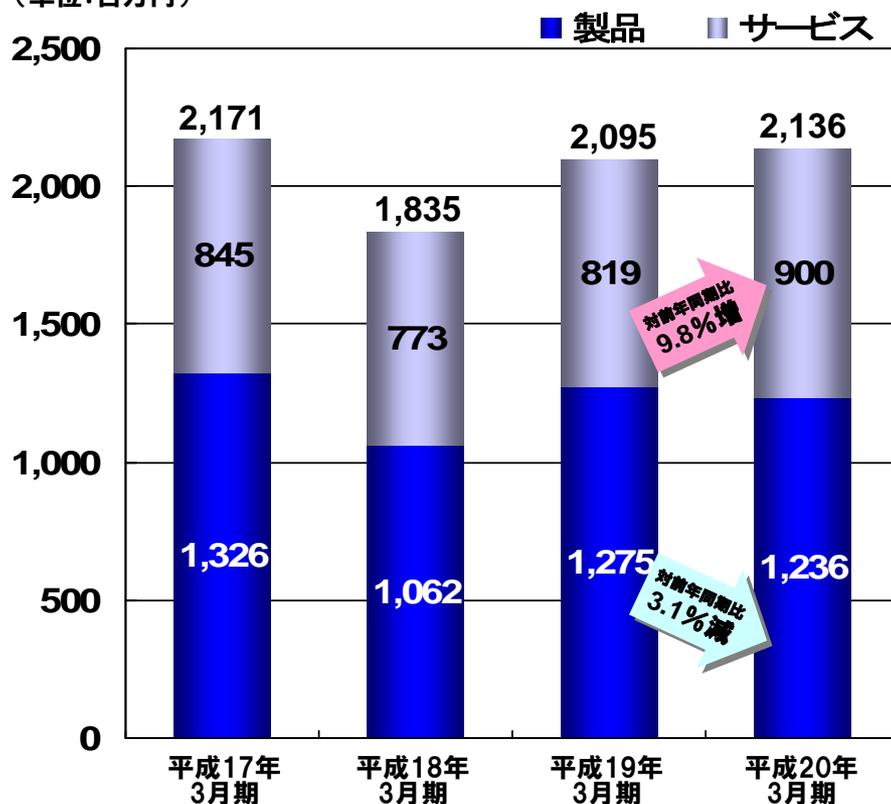
(単位:%)



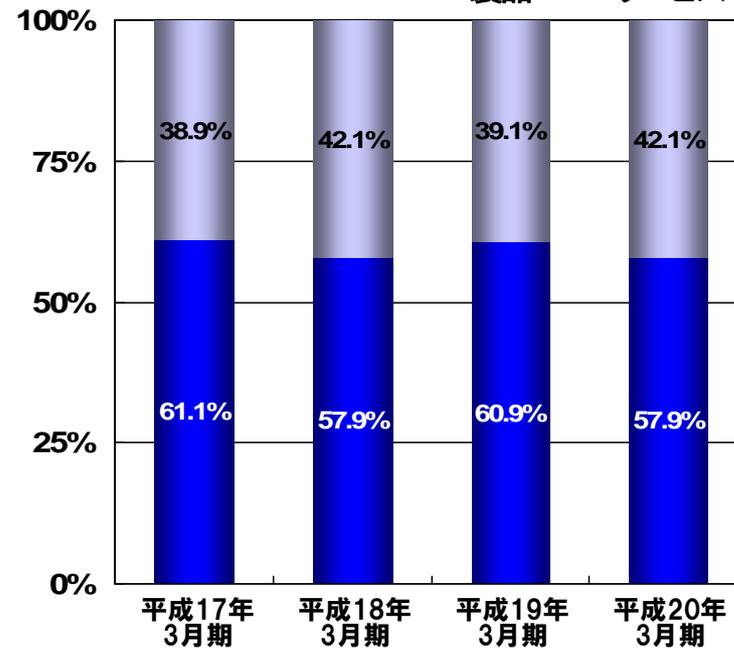
# 事業別売上高の推移(連結)

## 【製品/サービス別】

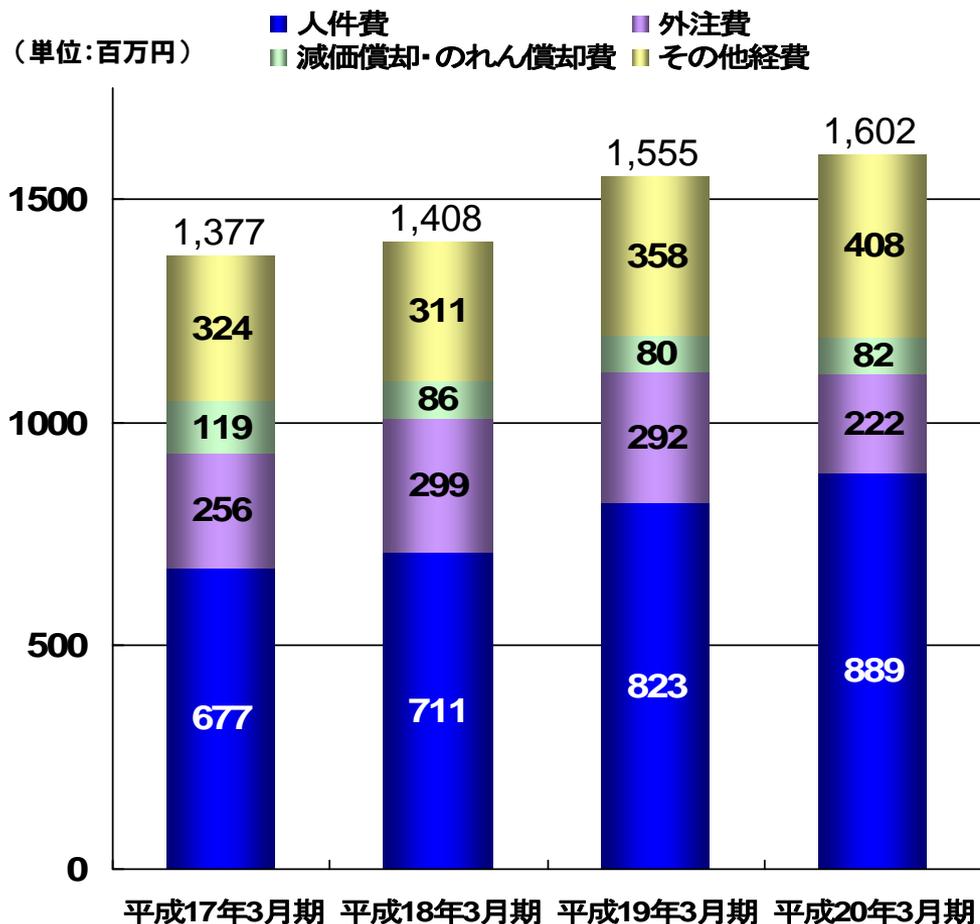
(単位:百万円)



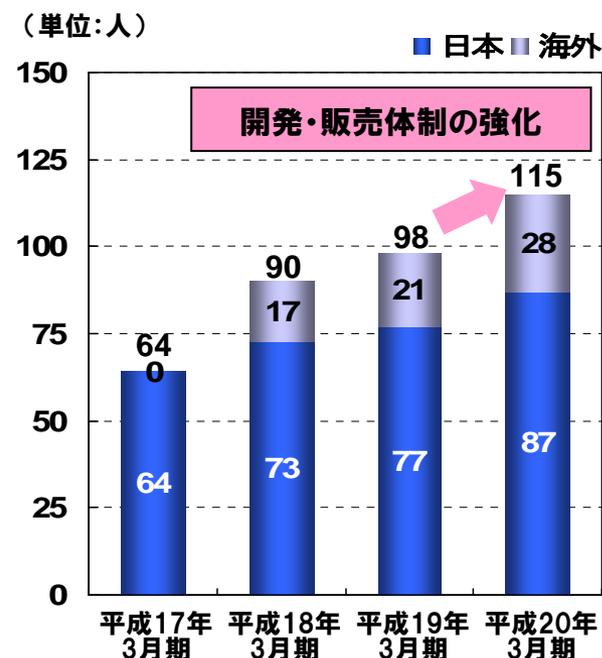
(単位:%)



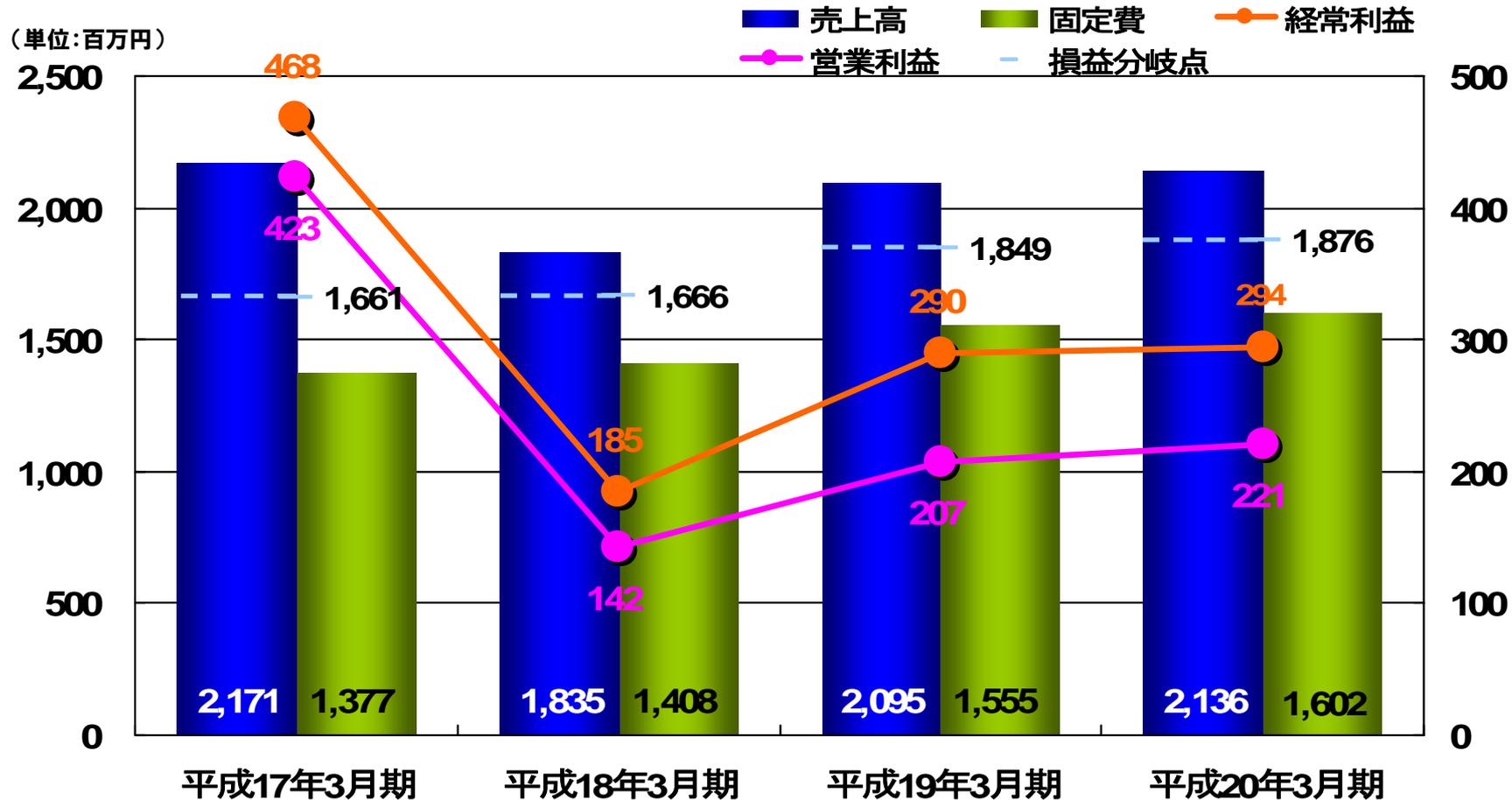
# 固定費内訳推移(連結)



## 【期末要員数】

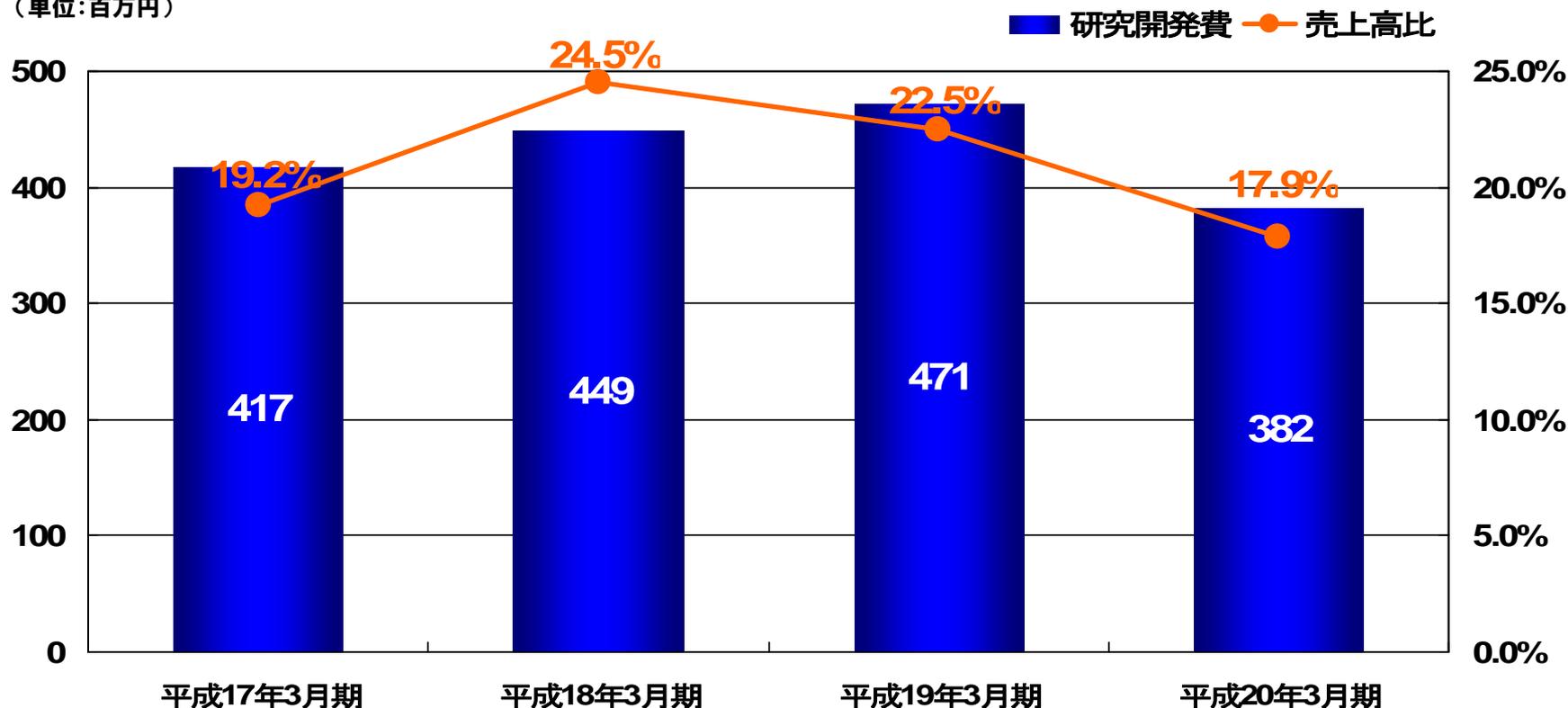


# 売上・利益の推移



# 研究開発費の推移

(単位:百万円)



研究開発費減少の主な要因は、研究開発リソースの一部を製品の完成度向上に投入したことによるものであります。

# 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	平成19年 3月期末	平成20年 3月期末	差異		平成19年 3月期末	平成20年 3月期末	差異
<b>(資産の部)</b>				<b>(負債の部)</b>			
<b>I 流動資産</b>	<b>2,488</b>	<b>1,894</b>	<b>△ 594</b>	<b>I 流動負債</b>	<b>502</b>	<b>561</b>	<b>58</b>
1 現金及び預金	1,917	1,348	△ 569	1 買掛金	138	148	9
2 受取手形及び売掛金	481	421	△ 59	2 未払法人税等	101	115	13
3 たな卸資産	17	27	10	3 賞与引当金	82	87	5
4 繰延税金資産	42	56	13	4 その他	179	209	29
5 その他	29	40	10	<b>負債合計</b>	<b>502</b>	<b>561</b>	<b>58</b>
<b>II 固定資産</b>	<b>310</b>	<b>1,076</b>	<b>766</b>	<b>(純資産の部)</b>			
1 有形固定資産	21	24	3	<b>I 株主資本</b>	<b>2,293</b>	<b>2,428</b>	<b>135</b>
2 無形固定資産	78	8	△ 70	1 資本金	760	760	-
(1) のれん	71	-	△ 71	2 資本剰余金	890	890	-
(2) ソフトウェア	6	8	1	3 利益剰余金	642	810	168
3 投資その他の資産合計	210	1,043	833	4 自己株式	-	△ 32	△ 32
				<b>II 評価・換算差額等</b>	<b>2</b>	<b>△ 19</b>	<b>△ 21</b>
				その他有価証券評価差額金	0	△ 21	△ 21
				為替換算調整勘定	2	2	0
				<b>純資産合計</b>	<b>2,295</b>	<b>2,409</b>	<b>114</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,798</b>	<b>2,970</b>	<b>172</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>2,798</b>	<b>2,970</b>	<b>172</b>

投資その他の資産の増加は、流動資産から長期性預金への預入れ7億円及びTakumi社への投資1億円によるものであります。

# 連結キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)

	平成19年 3月期末	平成20年 3月期末	差異
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	319	322	3
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 24	△ 829	△ 804
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	1,004	△ 61	△ 1,066
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	△ 0
V 現金及び現金同等物の増減額	1,299	△ 569	△ 1,868
VI 現金及び現金同等物の期首残高	617	1,917	1,299
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,917	1,348	△ 569

# 平成20年3月期トピックス

- **主力製品：α-SX V3.1.0のリリース（4月）**
  - 主に設計下流系(レイアウト設計)製品の強化



- **Takumi社との提携、同社へ投資（5月）**

- DFM分野のラインナップ強化



- **A-Solution設立（7月）、Chipidea社との提携（8月）**

- アナログIP分野への進出



- **FishTail社との提携（10月）**

- 半導体理工学研究センター（STARC）の標準ツールとして採用（3月）



- **主力製品：α-SX V3.2.0のリリース（12月）**

- 主に設計上流系(回路設計)との統合を強化



- **自己株式の取得（2-3月）**

- 取得株式数：300株 取得金額：32,676,700円



1.平成20年3月期 業績

2.平成21年3月期 業績予想

# 平成21年3月期予想(連結)

(単位:百万円)

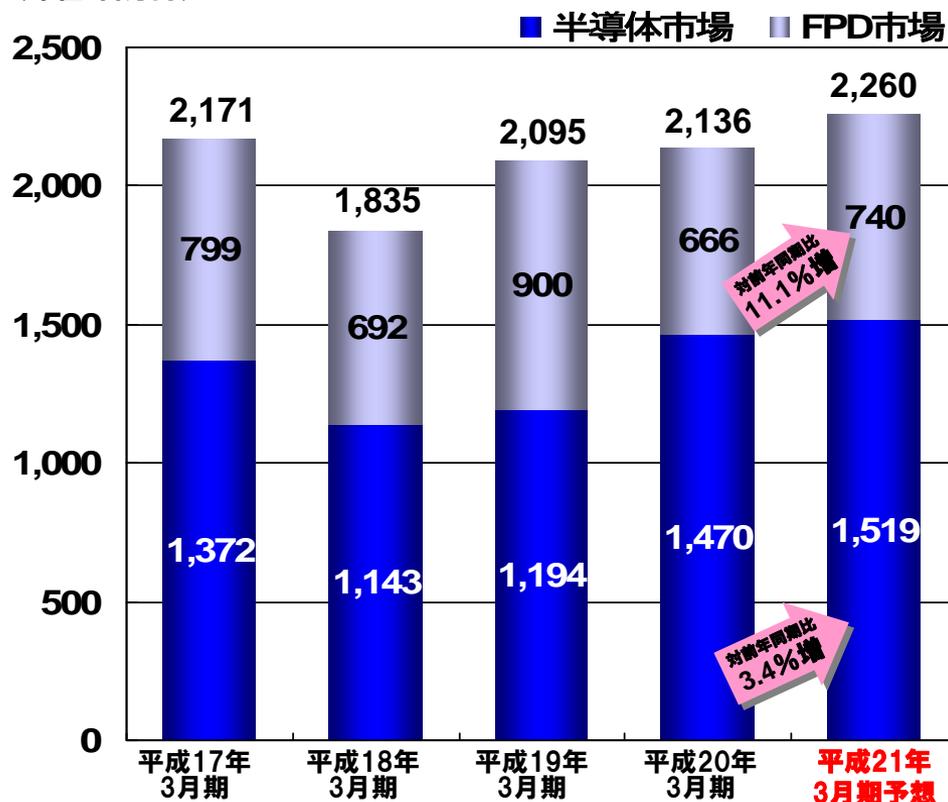
	平成20年3月期業績		平成21年3月期業績予想		
	実績	売上高比	予想	売上高比	対前年同期比
売上高	2,136	100.0%	2,260	100.0%	+5.8%
売上総利益	1,478	69.2%	1,561	69.1%	+5.6%
販売費及び 一般管理費	1,256	58.8%	1,276	56.5%	+1.6%
営業利益	221	10.4%	285	12.6%	+28.4%
経常利益	294	13.8%	310	13.7%	+5.2%
当期純利益	197	9.2%	200	8.8%	+1.3%

営業利益の伸びに対して、経常利益、当期純利益の伸びが低いのは、受取研究開発助成金が当連結会計年度比39百万円(69.9%)減少の17百万円を見込んでいるためであります。

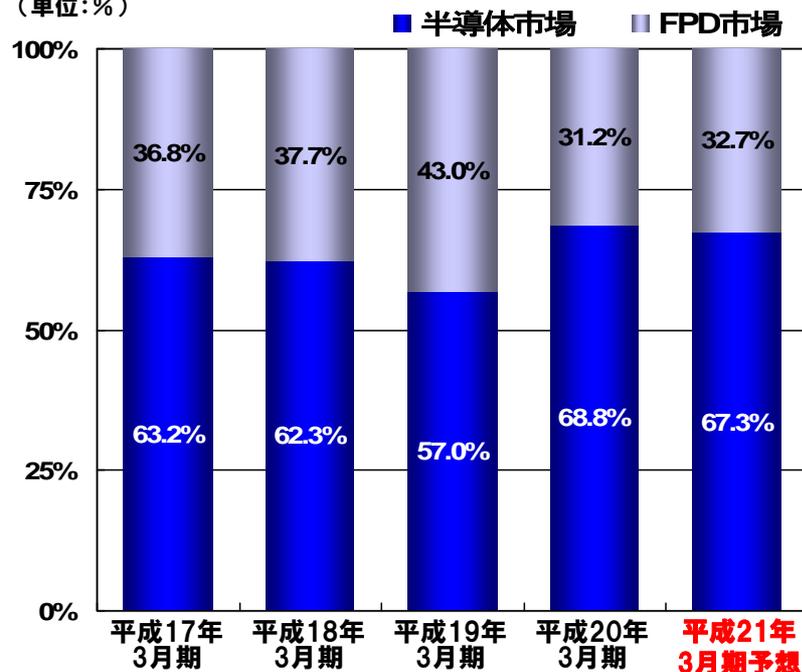
# 事業別売上高の推移(連結)

## 【半導体市場/FPD市場別】

(単位:百万円)



(単位:%)

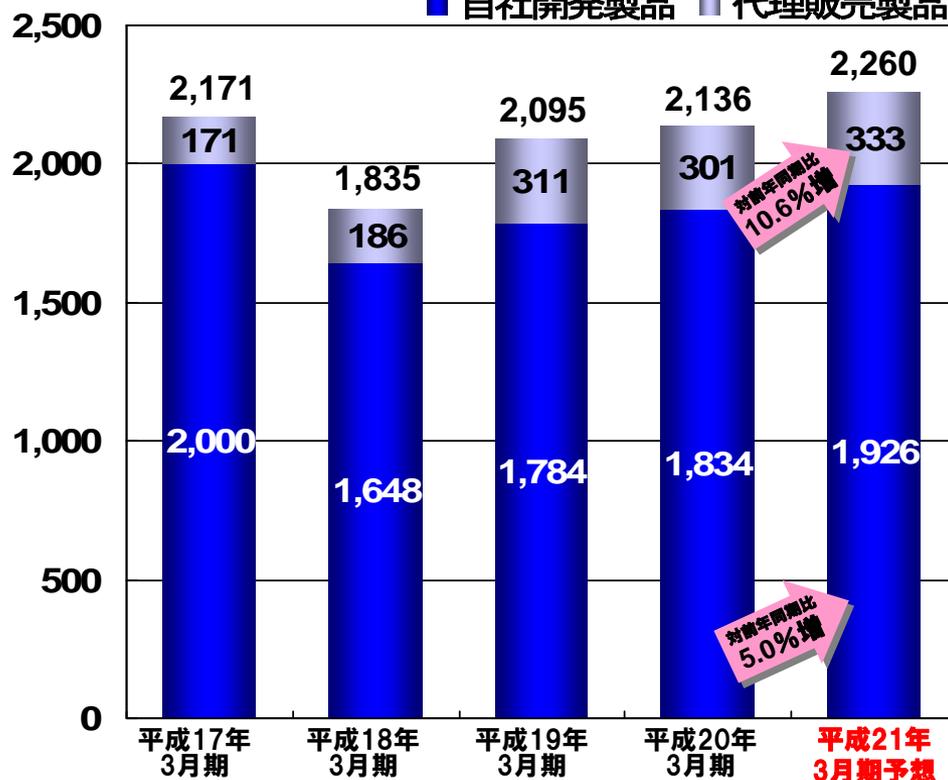


# 事業別売上高の推移(連結)

## 【自社開発製品/代理販売製品別】

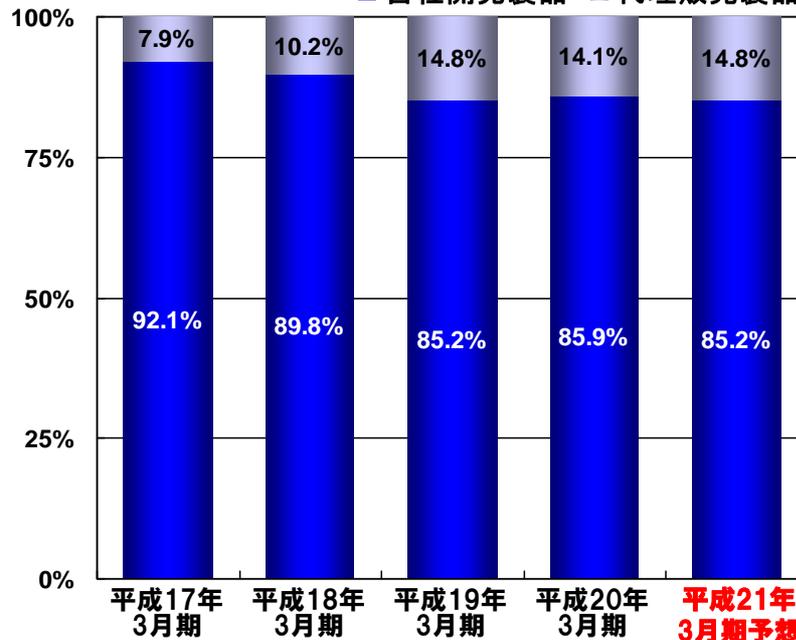
(単位:百万円)

■ 自社開発製品 ■ 代理販売製品



(単位:%)

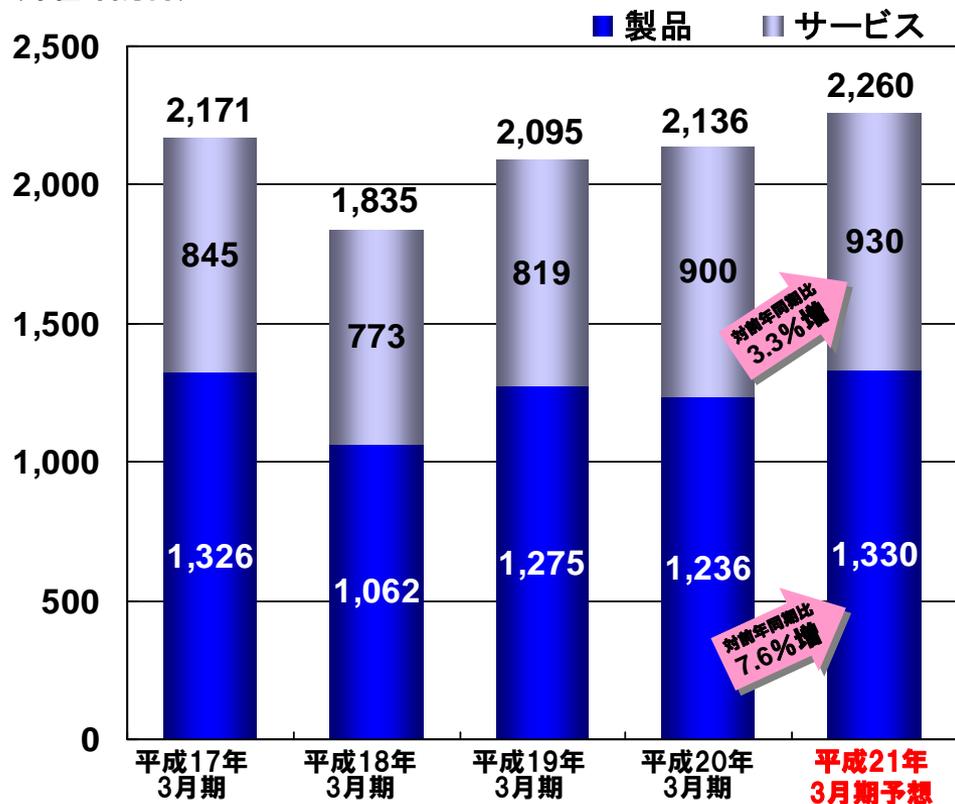
■ 自社開発製品 ■ 代理販売製品



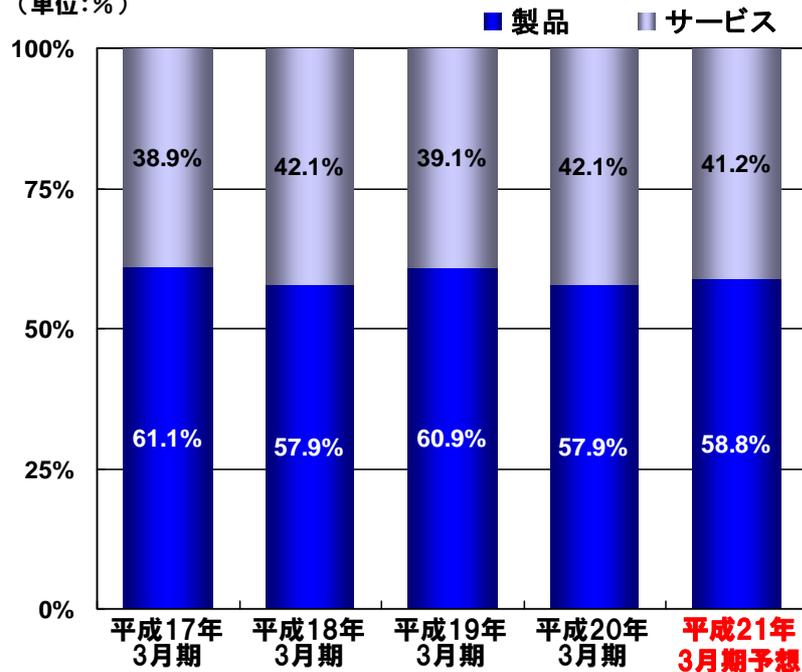
# 事業別売上高の推移(連結)

## 【製品/サービス別】

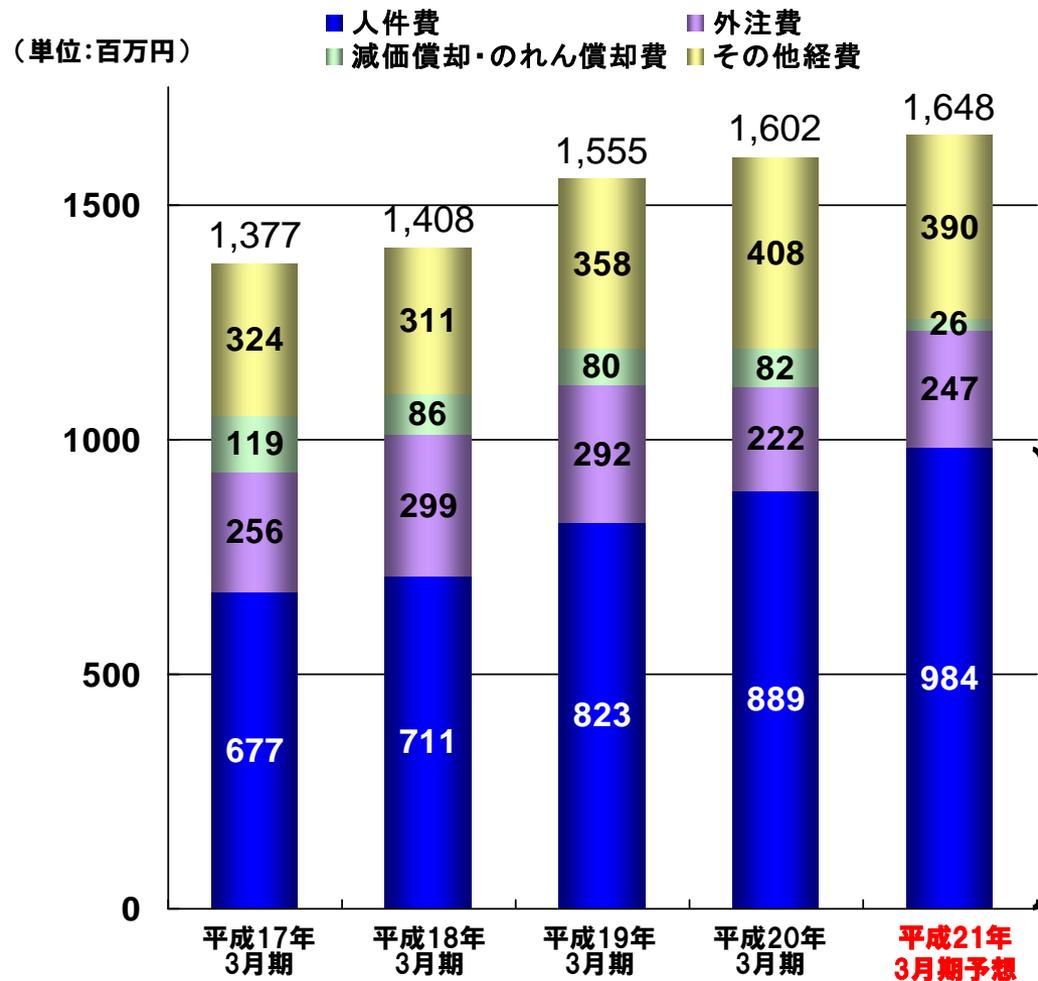
(単位:百万円)



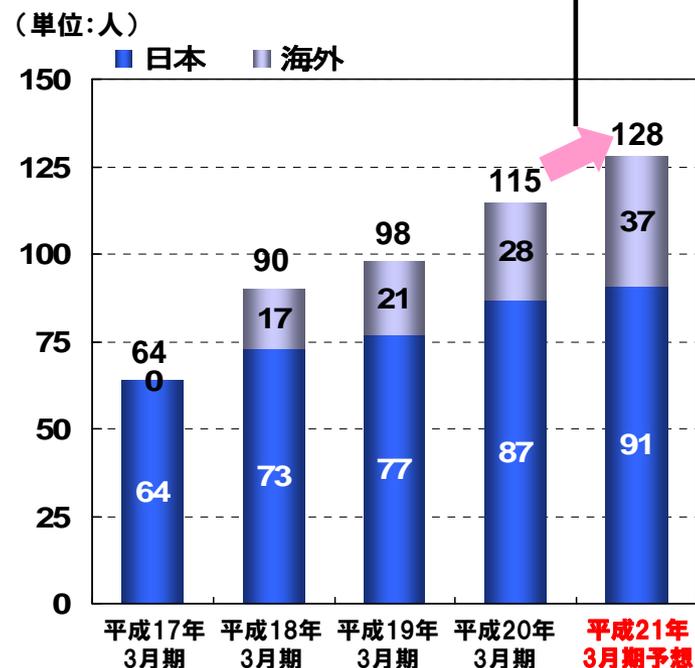
(単位:%)



# 固定費内訳推移(連結)

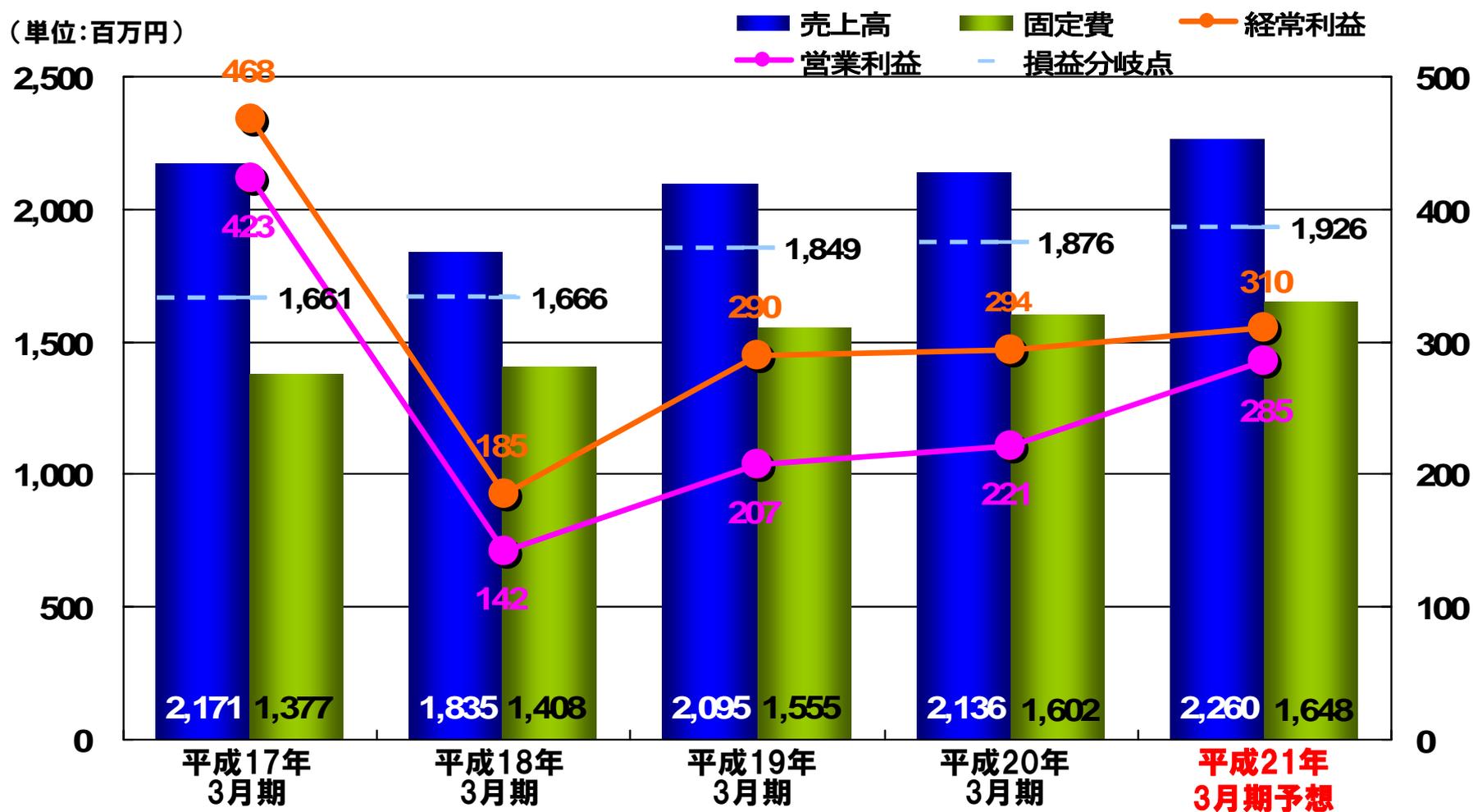


## 【期末要員数】



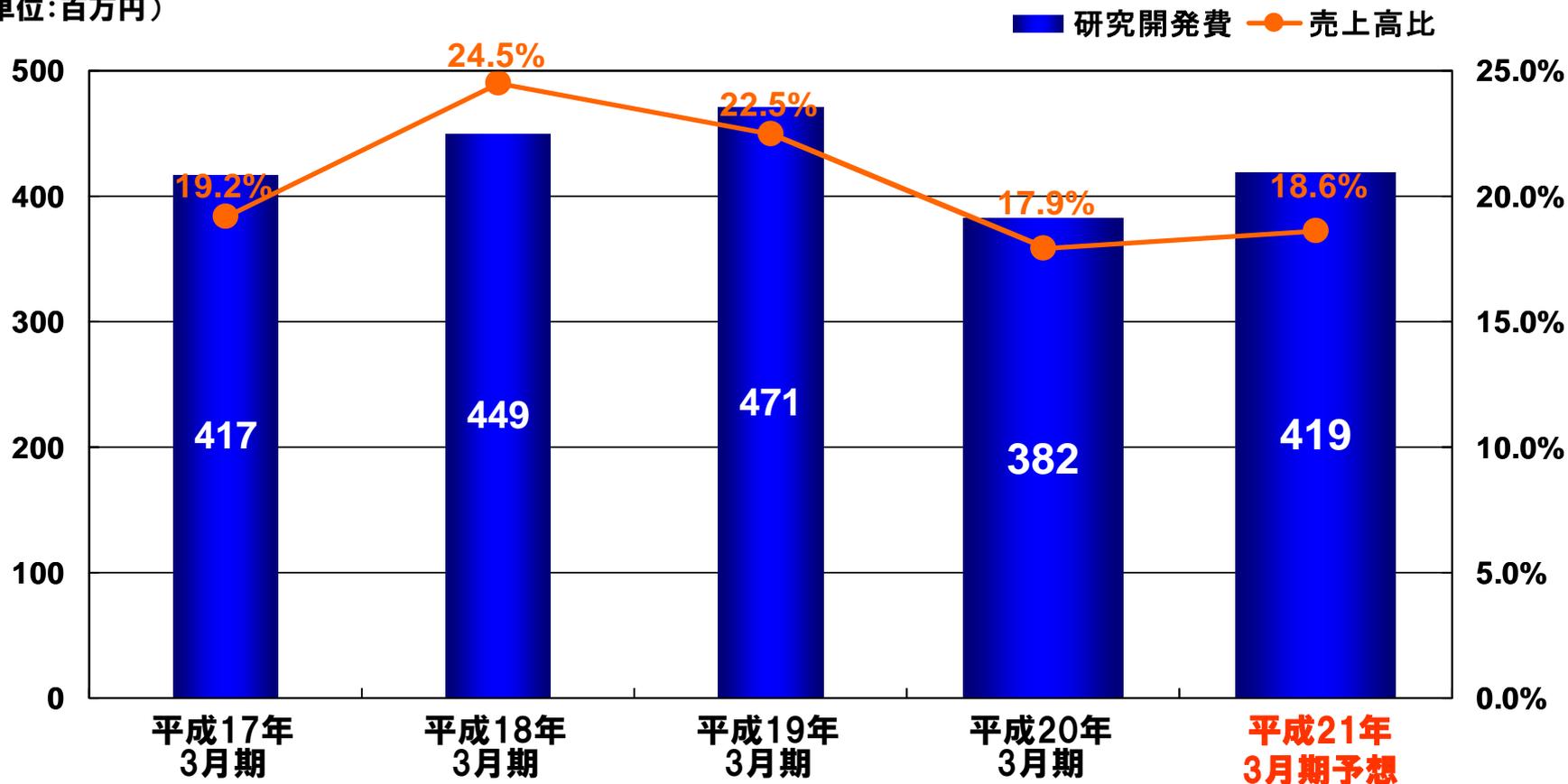
# 売上・利益の推移

(単位:百万円)



# 研究開発費の推移

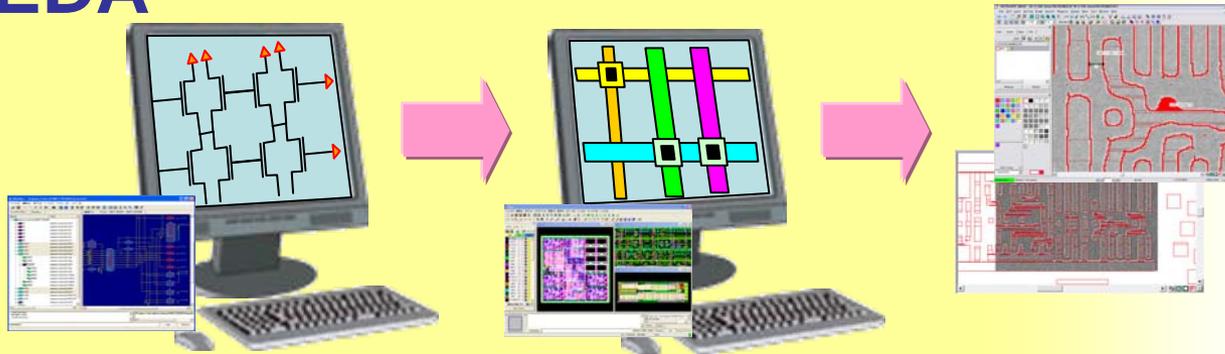
(単位:百万円)



# LSIの設計・製造工程

## 設計工程

### EDA



### 設計上流系 (回路設計)

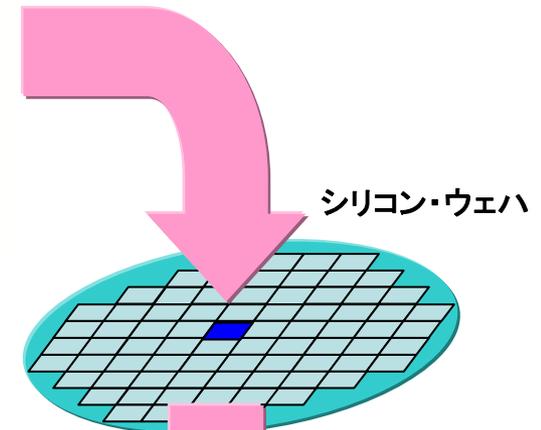
### 設計下流系 (レイアウト設計)

### DFM (製造考慮設計)

LSIの設計工程(EDA)は、大別すると設計上流系(回路設計)と設計下流系(レイアウト設計)に分かれる  
近年さらに、製造を考慮した設計工程(DFM)が加わった

## ウェハ処理工程 (前工程)

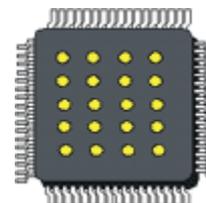
EDAで設計したレイアウトパターンをウェハに形成する



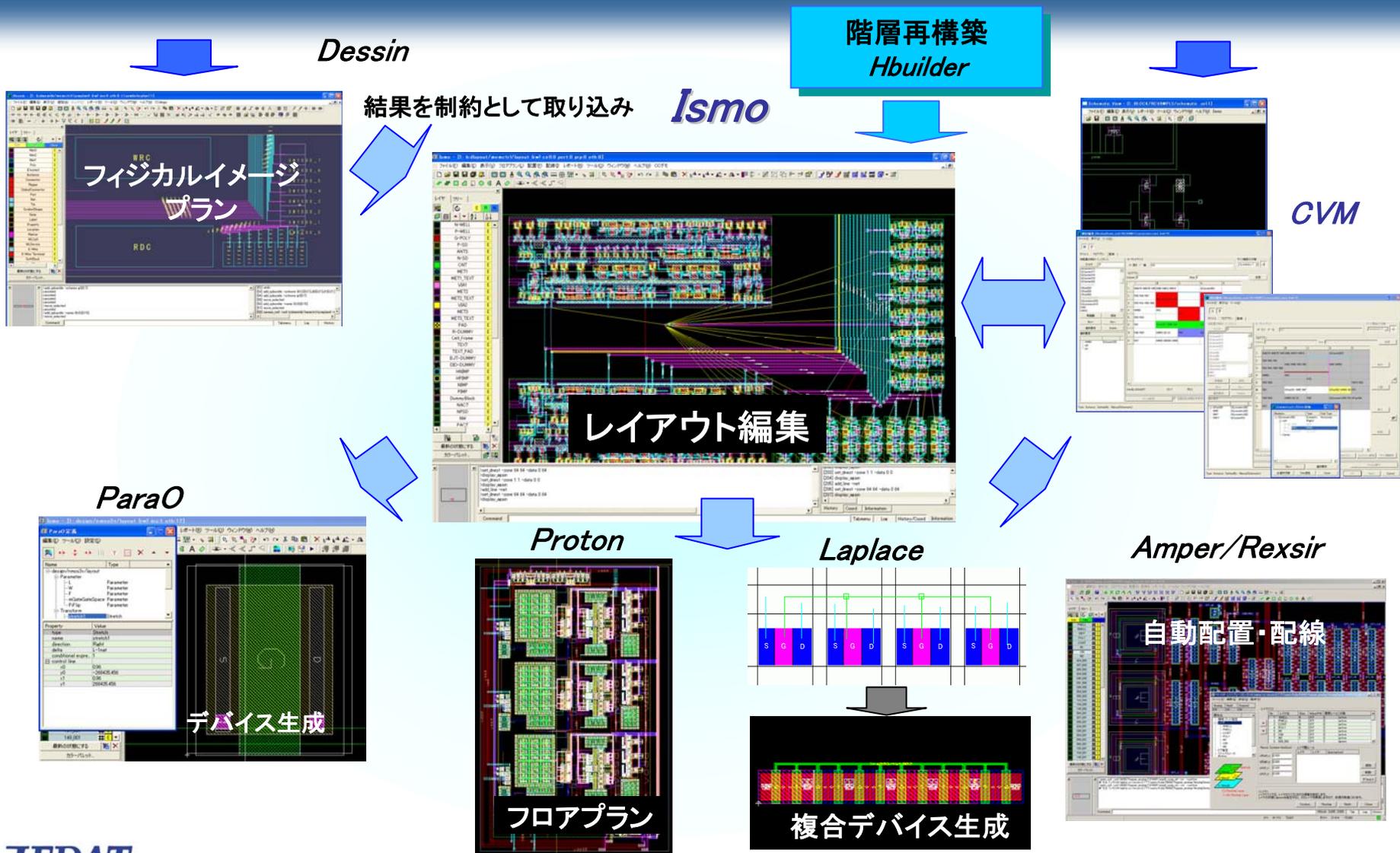
## 組立工程 (後工程)

ウェハから切り離れたチップをパッケージに実装する

LSI

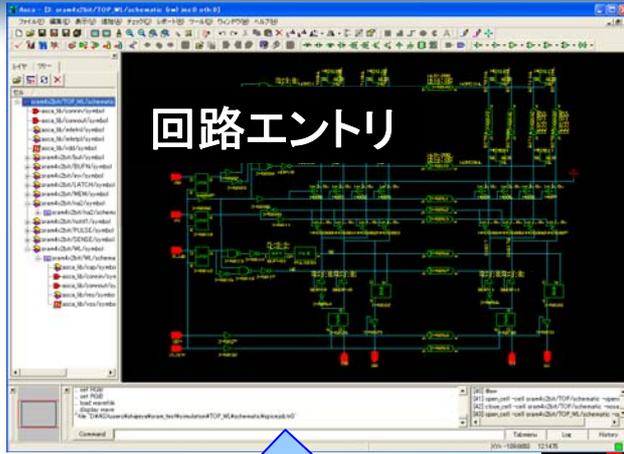


# 設計下流系(レイアウト設計)製品群

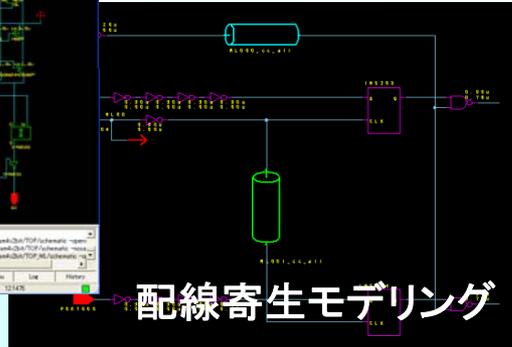


# 設計上流系(回路設計)製品群

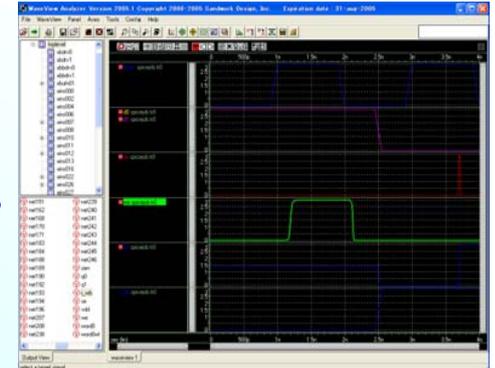
Asca



WLModeler



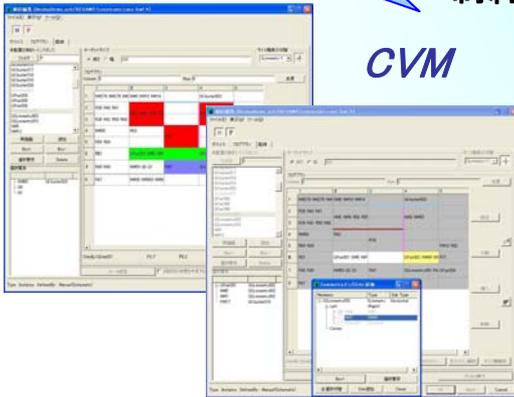
SPICE Sim



Coulom

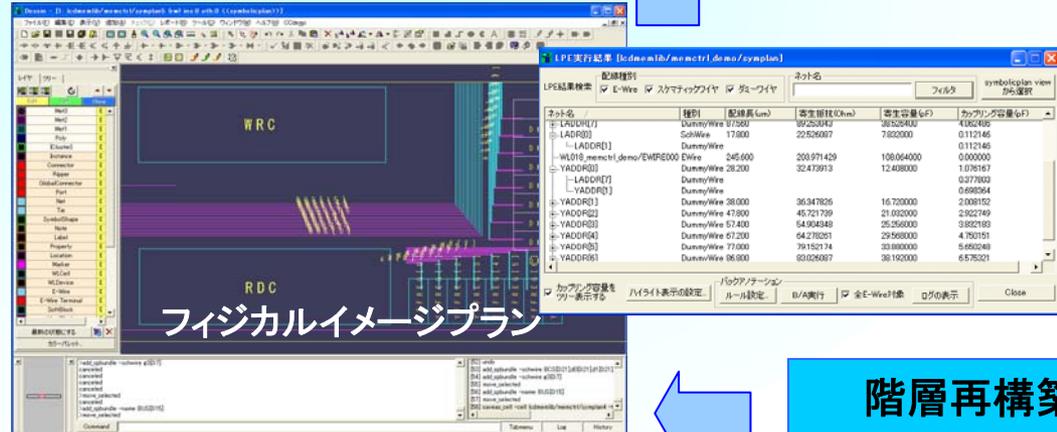
制約抽出

CVM



+

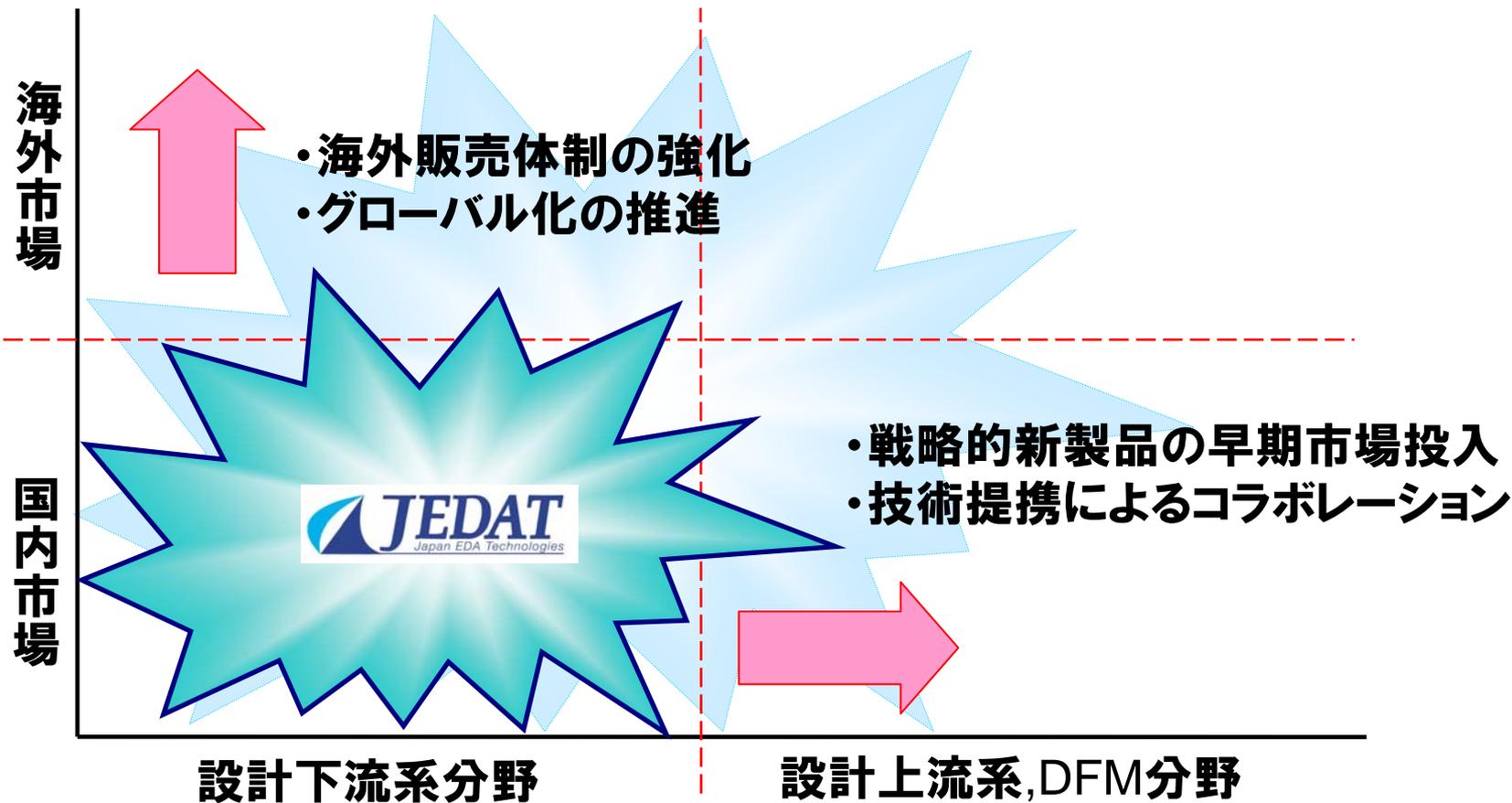
寄生RC



階層再構築  
Hbuilder

Dessin

# 今後の拡大戦略



# 重点施策

## 設計上流系(回路設計)分野への 開発投資を拡大

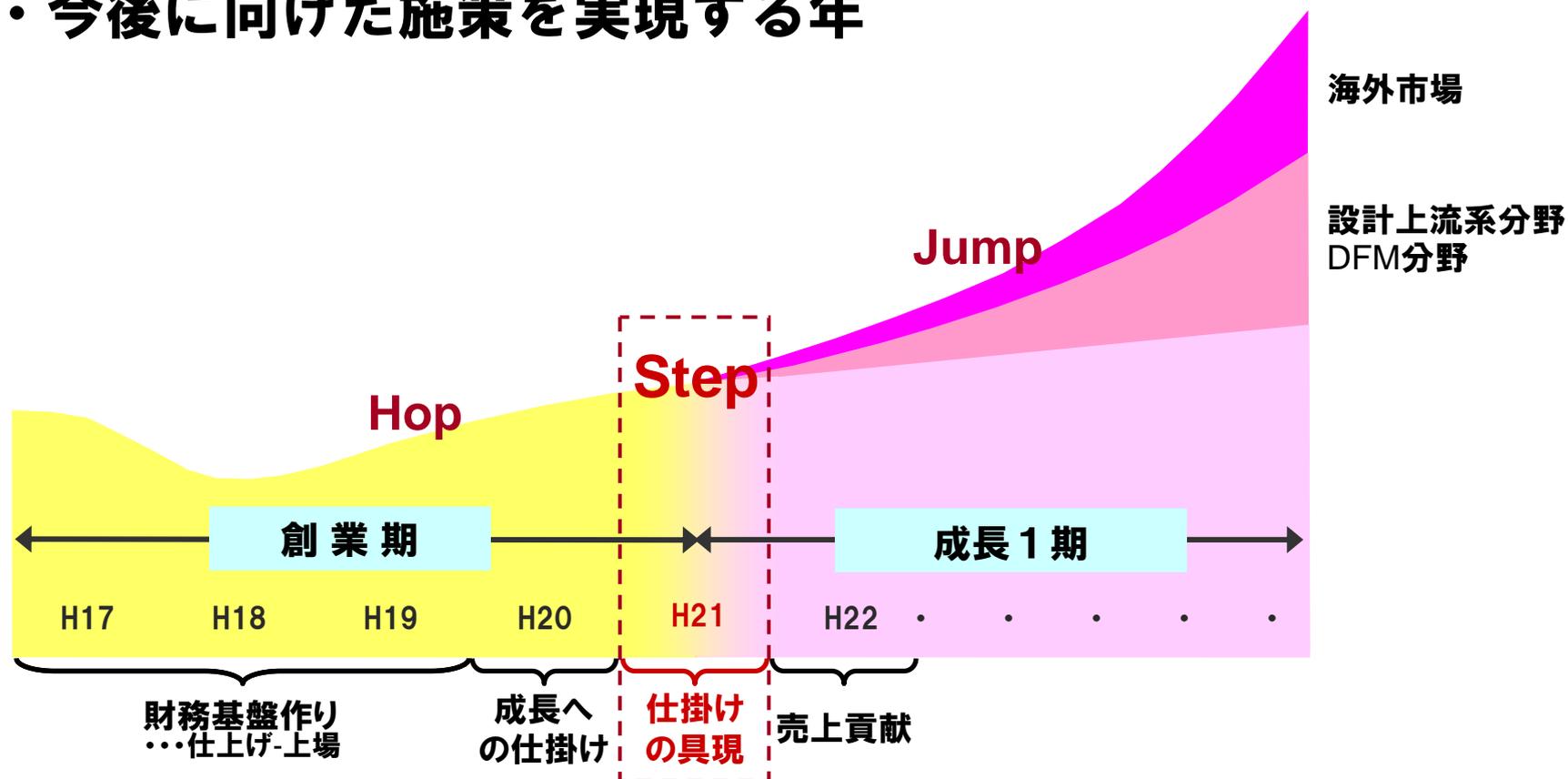
- 戦略的新製品の早期市場投入
- 設計・デバッグ環境の充実  
～ 設計者に優しいツール、感動を与えるツールの実現～

## 海外販売体制の強化

- FPD向け製品、HOTSCOPE製品の販売強化

# 平成21年3月期の位置づけ

- ・ 創業期から成長期への転換点（「Step」の位置付け）
- ・ 今後に向けた施策を実現する年



**ご清聴有難うございました**